

关于池州华宇电子科技股份有限公司 公开发行股票并在北交所上市 申请文件的审核问询函

池州华宇电子科技股份有限公司并华创证券有限责任公司：

现对由华创证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）保荐的池州华宇电子科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行股票并在北交所上市的申请文件提出问询意见。

请发行人与保荐机构在 20 个工作日内对问询意见逐项予以落实，通过审核系统上传问询意见回复文件全套电子版（含签字盖章扫描页）。若涉及对招股说明书的修改，请以楷体加粗说明。如不能按期回复的，请及时通过审核系统提交延期回复的申请。

经签字或签章的电子版材料与书面材料具有同等法律效力，在提交电子版材料之前，请审慎、严肃地检查报送材料，避免全套材料的错误、疏漏、不实。

本所收到回复文件后，将根据情况决定是否继续提出审核问询意见。如发现中介机构未能勤勉尽责开展工作，本所将对其行为纳入执业质量评价，并视情况采取相应的监管措施。

提 示

以下问题涉及重大事项提示及风险揭示：问题 1.创新特征与市场空间披露准确性，问题 2.业绩波动合理性及收入确认合规性，问题 3.毛利率下滑原因及期后下滑风险，问题 4.固定资产增长真实性及与产能匹配性，问题 6.募投项目的必要性及合理性。

目 录

一、业务与技术.....	3
问题 1.创新特征与市场空间披露准确性.....	3
二、财务会计信息与管理层分析.....	5
问题 2.业绩波动合理性及收入确认合规性.....	5
问题 3.毛利率下滑原因及期后下滑风险.....	7
问题 4.固定资产增长真实性及与产能匹配性.....	10
问题 5.其他财务问题.....	13
三、募集资金运用及其他事项.....	15
问题 6.募投项目的必要性及合理性.....	15
问题 7.其他问题.....	16

一、业务与技术

问题 1.创新特征与市场空间披露准确性

根据申请文件：（1）发行人提供的主要服务为集成电路封装测试、晶圆测试、芯片成品测试，封装业务包括 SOP、BGA 等多个系列超过 130 个品种，测试则覆盖 4 吋至 12 吋累计 30 余种测试方案。（2）2014 年至 2023 年，芯片封装测试市场规模整体呈增长态势，报告期内封装测试产品销售均价呈下行趋势，受集成电路行业景气度影响，发行人主营业务毛利率逐年下降。（3）截至报告期末，发行人生产人员 1,152 人，占员工总数的 75.99%。

（4）发行人共取得发明专利 40 项，实用新型 153 项，软件著作权 324 项，发行人研发费用占比低于同行业可比公司。

（5）发行人按照测试设备的技术参数和芯片类型将测试平台分为高端及中端，并将封装测试行业分为“行业内规模或技术具有领先优势的企业”等三类企业。

（1）关于发行人的市场空间。请发行人：①结合发行人客户结构及行业竞争格局补充披露发行人提供的服务在集成电路产业链中所处的位置，发行人与无晶圆厂、晶圆代工厂及集成器件制造商之间的业务联系。②进一步说明发行人对测试平台与封装测试行业进行分类的依据及合理性，发行人所处的“中等规模企业”层级在细分行业中的占比及相应细分层级的竞争格局。③结合下游客户需求变化情况及整体行业周期运行情况，量化测算发行人市场空间及市

场规模增速，并说明发行人在行业中的市场地位、市场份额。④结合同行业可比公司生产经营情况、发行人主要产品及服务产销量变化情况、报告期后封装测试产品销售单价变动情况，发行人封装测试的品种及测试方案类型，说明发行人封装测试业务报告期后的发展方向、行业政策及未来发展变动趋势，以及发行人应对下游行业下行风险的具体措施。

（2）关于发行人的研发能力与创新特征。请发行人：

①说明发行人受让取得的 52 项专利及 4 项集成电路布图设计专有权的背景、定价合理性，与发行人核心技术的关系，是否存在权属纠纷。②说明发行人员工人数、员工任职结构、员工学历结构与同行业可比公司的差异情况；发行人自主研发的 3D 编带机等设备在实际生产中的应用及与具体业务类型的对应关系，自主研发设备在业务中的重要性，相应业务占报告期各期营业收入的比例，结合上述情况说明发行人主要产能、业绩增长是否受外采标准化设备或生产人员规模驱动，发行人生产活动是否存在资金及劳动密集型特征，发行人业务是否存在技术壁垒，并针对性进行风险提示。③说明发行人软件著作权与测试品类的对应关系，相关软件著作权成果的复用率；结合同行业可比公司专利、软件著作权取得情况，核心技术在生产中的应用情况，下游客户的需求情况及行业内技术的迭代情况，进一步说明发行人在同行业的研发能力与竞争优势的具体体

现，发行人核心技术是否与同行业通用技术形成差异，发行人封装测试能力、技术迭代能力是否与半导体行业发展相匹配。

请保荐机构对上述问题进行核查并发表明确意见。

二、财务会计信息与管理层分析

问题 2.业绩波动合理性及收入确认合规性

根据申请文件及公开信息：（1）报告期内发行人营业收入分别为5.58亿元、5.78亿元、6.83亿元，受毛利率下滑及政府补助下降影响，2022年、2023年发行人净利润同比下降34.69%、51.12%。（2）发行人主要提供芯片的封装测试服务，根据合同约定将客户的交付产品或待加工标的物加工完成后交付至客户指定地点，客户接受产品并经双方对账无误后确认收入。（3）报告期各期应收账款账面余额分别为1.05亿元、1.33亿元、1.11亿元，2023年末应收账款余额较2022年末增长26.03%，高于同期营业收入增长率，主要原因为下游行业景气度下行，部分客户的回款周期有所延长。（4）发行人各期境外销售收入占营业收入比重分别为8.21%、7.49%、8.84%。

（1）业绩波动合理性及期后下滑风险。请发行人：①说明各期终端应用领域的销售收入及占比、客户数量，结合细分产品收入、成本、毛利率变动，说明报告期内发行人收入规模持续增长的真实性、合理性，与行业数据及主要客户对外销售情况的匹配性。②说明2022年、2023年发行

人净利润下滑的具体原因，是否存在低价竞争、利润空间被压缩的风险。③结合主要客户合作背景、获客渠道、发行人产品供货份额、各期销售情况，说明发行人与主要客户合作的稳定性；说明部分客户为前员工设立、注册资本及参保人数较少的合理性，是否涉及潜在关联关系或其他利益安排。④结合境外客户的业绩情况、合作时间、定价政策、结算方式等，说明境外销售收入增长的具体原因及真实性，增长趋势与可比公司是否一致；结合与境外主要客户的合作背景、产品优势、在手及新增订单情况，分析发行人与境外主要客户合作的稳定性，境外业务收入增长是否可持续。⑤结合在手订单及期后业绩、境内外市场终端需求及行业竞争格局变动、产品调价情况、议价能力、相关政策及贸易环境、新客户开发情况，说明发行人是否存在业绩下滑风险，相关风险是否充分揭示。

（2）收入确认合规性。请发行人：①说明收入确认的具体依据，结合各期产品交付与结算的平均时间间隔、责任划分、对账周期、发出商品与期后结算收入的差异，说明是否存在跨期或调节收入的情形，收入确认政策是否符合《企业会计准则》规定，与同行业可比公司是否存在差异。②说明两类主要业务收到客户的交付产品或待加工标的物的流程、节点、主要保管责任方等，待加工标的物的验收、领用、对账与合同是否一致，是否存在加工物资的保管风险，结合具体合同约定，说明会计处理的合规性。③说

明报告期各期退换货的情况，列示客户名称、退换货原因、数量、金额、退换货条款、产品质量保证约定等及相关会计处理情况，说明存在跨期退换货情形时收入确认是否准确，未计提产品质量保证金的原因及合理性。

（3）应收账款回款风险。请发行人：①说明报告期内应收账款余额波动的原因及合理性，说明信用期外应收账款的形成原因、款项性质、对应业务内容、坏账准备计提充分性。②列表说明主要客户应收账款的回款情况、信用期等，说明部分客户的信用政策变化的原因，是否存在放宽信用期刺激销售的情况。③说明各期应收银行承兑汇票和商业承兑汇票的期初余额、本期收到金额、本期兑付及支付金额、背书转让、贴现、期末余额、到期承兑情况，以及票据贴现利息费用的确认方式、金额；说明各期应收票据余额逐年波动的原因及合理性，背书、转让等相关会计处理的合规性。

请保荐机构、申报会计师：（1）核查上述问题并发表明确意见，说明核查方式、过程、范围和结论。（2）按照《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规则适用指引第2号》（以下简称《2号指引》）2-13境外销售的要求核查并发表明确意见。（3）说明对发行人收入真实性采取的核查手段、比例及结论。

问题 3.毛利率下滑原因及期后下滑风险

根据申请文件：（1）报告期内发行人主营业务毛利率

分别为 28.56%、22.29%和 21.18%，逐年下降且高于可比公司平均数。（2）报告期内发行人封测业务毛利率分别为 21.98%、12.91%、10.84%，下滑原因主要为封测产品价格下调及单位产品平均成本上升，同行业可比公司封测业务毛利率平均数为 14.07%、6.24%、10.13%；专业测试业务毛利率分别为 42.52%、40.02%、39.14%，下降幅度低于同行业可比公司同类业务。（3）报告期各期发行人向不同客户间销售毛利率差异较大；各期境外客户毛利率均高于境内客户毛利率。（4）报告期内发行人主营业务成本中制造费用占比均超 50%。

（1）封测业务毛利率下滑原因及高于可比公司合理性。请发行人：①说明封测业务主要产品的销售定价机制；报告期内封测业务各细分产品销售均价下降的原因及合理性，与市场价格变动趋势是否一致，2024年第二季度起发行人产品销售价格逐渐企稳的具体依据；量化说明封测业务各细分产品销售均价下降对毛利率的具体影响。②说明封测业务可比公司的选取依据、选取范围及合理性；结合产品结构、售价差异、单位成本、销售规模、定价机制、客户类型、细分市场优势、行业地位，说明封测业务产品毛利率高于可比公司的原因及合理性。③按主要客户列表说明封测业务各细分产品销售金额、单价、毛利率等，说明向主要客户的销售情况、定价政策和调价机制等存在的差异及合理性，量化分析封测业务各细分产品不同客户销售毛

利率存在差异的原因、同一客户报告期内销售毛利率下滑的原因及合理性。

（2）测试业务毛利率较高的合理性及综合毛利率持续下滑风险。请发行人：①结合产品特点、竞争优势、下游客户需求变动情况、销售与采购价格水平，说明专业测试业务毛利率维持较高水平的原因及合理性。②结合与同行业可比公司在技术水平、成本结构、议价能力、供应商与客户类型等方面的差异情况，分析专业测试业务毛利率高于可比公司的原因及合理性。③说明报告期后发行人细分产品销售单价、成本、毛利率变动情况；结合期后各类产品原材料市场价格变化、产品销售价格波动情况，说明是否存在毛利率继续下降的风险及应对措施。④说明毛利率为负的产品类型、销售情况、销售价格、成本，结合与客户的定价策略、合作年限、低报价对扩大销售的效果说明负毛利率销售的原因。⑤结合销售价格、客户议价能力、市场竞争格局、结算方式差异等因素，说明境外毛利率高于境内、与可比公司不一致的原因及合理性。

（3）采购价格公允性及成本核算准确性。请发行人：①补充披露制造费用及其他成本的具体构成、金额及占比；说明制造费用中折旧及摊销与发行人机器设备的匹配关系，2023年固定资产增长的情况下，制造费用中折旧费占比下降的合理性；说明制造费用中辅材及周转材料用量与相关工序产量变动的匹配关系，主要能源的采购量、耗用

量、产品产销量、库存的匹配关系，各期投入产出比是否存在异常；说明生产辅助人员的部门、职能、人数及人工成本金额，间接人工成本金额持续上升的原因，相关人均薪酬的合理性；结合各类产品制造费用的构成、固定和变动制造费用划分、产销量，说明各产品单位制造费用变动原因及核算准确性。②结合引线框架、塑封树脂等主要原材料采购数量、金额、占比及平均单价，说明直接材料占比持续下降的原因；结合各类产品单位原材料消耗用量，说明各类原材料采购入库、生产领用、期末库存情况，与各期产品产销量、期末库存的匹配性。③说明人工费用的分配方式、结合报告期内生产人员人数变动、年龄结构、平均工资及变动，说明直接人工占比逐年增长的合理性及核算的准确性。④说明成立时间短或参保人数少、已注销、存在关联关系等供应商名称、采购内容、采购金额及占比、结算政策等情况，以及采购的原因及合理性。

请保荐机构、申报会计师核查上述问题并发表明确意见，说明核查方式、过程、范围和结论。

问题 4.固定资产增长真实性及与产能匹配性

根据申请文件：（1）报告期各期末发行人固定资产账面价值分别为 6.86 亿元、7.68 亿元和 12.08 亿元；发行人存在购买二手设备的情况。（2）截至 2024 年底，用于融资性售后回租业务的固定资产账面价值为 1.60 亿元，长期应付款中应付融资租赁款为 4,434.45 万元。（3）各期末在建工

程余额分别为 3,379.87 万元、23,597.55 万元、9,970.92 万元，各期转入固定资产金额分别为 2.24 亿元、1.49 亿元、1.91 亿元。（4）报告期各期末发行人资产负债率分别为 46.74%、54.75%、61.39%，逐年增加。

（1）固定资产增长规模与产能匹配性。请发行人：①结合主要生产线的投产时间、固定资产情况及种类、生产人员数量、开工时长，说明报告期内产能与固定资产规模、生产人员数量的匹配关系，说明报告期内发行人持续加大固定资产投资的合理性、必要性；结合终端需求变化、在手订单等说明新增产能的消化方式，是否存在新增产能无法消化风险。②说明采购二手设备的原因、定价依据、成新率及剩余折旧年限计算方法；说明各生产线对应的主要产品、各期产量、自动化水平、各环节员工配置等情况。③说明报告期内各租赁设备名称、出租方、租赁开始日及周期、租赁资产公允价值、最低租赁付款额现值、折现率及其确定过程、入账价值及其变动情况、长期应付款的初始账面值及其变动情况，说明售后回租业务相关会计处理的合规性；结合偿债能力、售后回租设备与自有设备的性能差异等说明采用售后回租的原因及商业合理性，量化分析上述设备购买与售后回租分别对业务的影响金额；说明报告期各期售后回租应付融资租赁款与融资租赁保证金的匹配关系，售后回租相关业务开展与收到的融资租赁款、融资租赁支付的现金的勾稽关系。

（2）在建工程真实性及转固时点准确性。请发行人：

①说明报告期内主要工程、固定资产供应商的筛选标准、获取渠道、合同内容，说明在建工程对应采购款的具体支付情况、支付对象、付款周期与建设进度及合同约定是否匹配。②按照采购内容列表说明在建工程、固定资产对应的供应商名称、成立时间、合作时间、注册及实缴资本、人员及经营规模、各期采购金额、采购方式（是否招投标）、是否与发行人及相关人员存在关联关系或非经营性资金往来。③分别说明合肥集成电路测试产业基地项目、池州三期厂房装修、深圳厂房装修、在安装设备等主要在建项目的建设背景、采购方式、预算金额、招投标报价均价与中标价差异率、合同价与转固金额差异率、项目总投资金额、项目进度、各期增加及转固金额、利息资本化、费用化情况及具体计算过程，结合各期转入固定资产的具体内容及构成情况、作价依据，说明采购价格公允性，是否包含与在建工程无关的其他开支。④说明固定资产、在建工程盘点情况，包括盘点时间、地点、人员、范围、方法、程序、比例、结果，是否存在盘点差异、产生原因及处理措施。

（3）偿债能力风险。请发行人：①说明报告期各期末短期借款、长期借款的明细情况，抵押借款、保证借款及信用借款时间、金额、利率、期限、担保方式等，结合业务开展情况、经营计划安排、融资成本等说明各期末短期借款持续增长、2024 年长期借款增长较大的原因及合理

性，大额借款对发行人财务状况的影响，是否依靠借款维持日常运营。②说明资产负债率持续增长的原因及发行人拟采取措施，结合营运资金、银行授信、工程后续资金投入等量化测算发行人偿债风险；结合行业周期、竞争状况、发展态势等因素，以及发行人主要业务数据、财务指标变动趋势及同行业差异等情况，说明发行人是否存在流动性风险；说明现有资产结构是否足以支撑发行人后续业务扩张。

请保荐机构、申报会计师：（1）核查上述问题并发表明确意见，说明核查方式、过程、范围和结论。（2）说明针对固定资产、在建工程的监盘情况（时点、地点、人员、比例）、监盘结果（不符或差异、结论），结合资金流水核查情况说明在建工程款是否流向发行人及其关联方、客户和其他供应商。（3）说明针对供应商的函证、走访情况，包括函证及走访主要核实确认内容、函证及走访最终确认金额及比例、核查结论等。

问题 5.其他财务问题

（1）存货跌价准备计提充分性。根据申请文件，报告期各期末，发行人存货账面价值分别为 6,786.36 万元、5,221.06 万元、7,130.24 万元，主要为原材料、在产品及库存商品。请发行人：①结合生产周期、在手订单、订单覆盖率等，说明 2023 年末发行人存货余额下降、2024 年末增长的原因；存货规模、结构与发行人的订单、业务规模的匹

配性，与可比公司是否存在较大差异。②结合库龄情况、存货跌价准备计提政策、主要产品售价变动、期后结转情况及毛利率等，说明各期存货跌价准备计提的充分性及合理性。③说明存货管理模式、盘点政策、存放地点、方式、存货出入库关键内部控制节点及执行情况；对各类存货盘点的具体情况，对非在库存货是否进行盘点及确认其金额的方式。

（2）研发费用归集核算准确性。根据申请文件，报告期各期，发行人研发费用分别为 3,324.33 万元、3,850.59 万元和 4,052.87 万元，研发费用率为 5.96%、6.66%、5.93%，低于可比公司平均水平，研发人员分为全职研发人员和兼职研发人员。请发行人：①说明研发工时记录相关流程，是否能够准确统计各研发项目研发人员的工时情况，相关研发项目负责人审批的依据，存在记录表签字人员与项目记录不一致的原因。②说明研发人员的认定标准及划分依据，报告期内研发人员数量、学历及专业等情况，说明兼职研发人员的具体情况，相关人员薪酬在生产成本与研发费用之间分配的准确性，部分关键管理人员兼职研发薪酬核算的准确性。③结合在研项目、研发成果、取得专利或技术情况等，说明研发支出的合理性，各期研发成果与研发人员、研发费用的匹配性。④结合产品定位、核心竞争优势、研发进展、研发产出及对业绩的贡献度等，说明研发费用率低于可比公司的原因及合理性。

（3）股份支付会计处理规范性。根据申请文件，2021年，发行人通过持股平台华宇芯管理实施股权激励，报告期内，发行人根据约定的服务期限摊销股份支付金额计入各期管理费用。请发行人说明历次股权激励的主要内容、相关协议签署情况和内容、员工出资情况、实际取得股份时点等，分析授予日、等待期及股份支付金额的准确性，持股平台内员工离职后股权回购情况和会计处理的合规性。

请保荐机构、申报会计师：（1）核查（1）-（3）问题并发表明确意见，说明核查方式、过程、范围和结论。

（2）按照《2号指引》2-4研发投入的要求核查并发表明确意见。

三、募集资金运用及其他事项

问题 6.募投项目的必要性及合理性

根据申请文件：（1）发行人本次拟募集 40,000.00 万元投向大容量存储器与射频模块封测数字化改造项目（以下简称“项目一”）、合肥集成电路测试产业基地晶圆测试及芯片成品测试项目（以下简称“项目二”）及补充流动资金。

（2）报告期内发行人封装测试的产能利用率低于 80%，芯片成品测试产能利用率低于 75%。（3）发行人本次募投项目一中的厂房及附属建筑为政府代建，建设完成后由政府租赁给发行人，发行人承诺 5 年内回购。

请发行人：（1）结合报告期内发行人下游行业周期运

行情况，项目一、项目二新增产能对应的集成电路品类及终端应用领域的需求变动，发行人产能利用率变动，在手订单履行情况，新客户的拓展情况等，说明在封装测试、芯片成品测试产能利用率未超 80%的情形下新增产能的必要性、合理性。（2）补充披露项目一环评审批、备案的办理进度，说明项目一政府代建相关协议的具体内容、履行进展、各方在不同阶段的权利义务、相关审批的履行情况，本次募投资金是否涉及土地租金或土地回购款；结合发行人报告期后业绩、在手订单及履行情况等，说明发行人是否存在无法履行回购承诺导致厂房及附属建筑被收回的风险，并完善相关风险提示。（3）说明预备费、铺底流动资金的测算依据、测算过程、必要性及合理性；结合募投项目长期资产、员工增加规模，量化分析折旧、摊销或新增人工成本对发行人未来成本、利润的具体影响，并完善相关风险提示。（4）结合发行人货币资金水平、生产经营流动性需求、现有资金募集渠道、报告期内分红情况等，说明补充流动资金的必要性、合理性。

请保荐机构核查上述问题并发表明确意见。请申报会计师核查上述问题之（3）并发表明确意见。

问题 7.其他问题

（1）发行人房屋抵押与租赁情况。根据申请文件，发行人有 7 处房屋建筑物处于抵押状态，子公司华力宇向黄田股份合作公司租赁的厂房被列入土地整备项目。请发行

人：①说明 7 处被抵押房屋的用途，占发行人及子公司房屋面积的比例，各个抵押房屋担保的主债权、债权人、担保期限，是否存在借款到期无法偿还而导致房屋被强制执行的风险。②说明被列入土地整备项目厂房的具体用途，量化测算该厂房搬迁对发行人生产经营及盈利能力的影响，是否对发行人生产经营构成重大不利影响。

（2）历史沿革与股权变动情况。根据申请文件，实际控制人2006年起陆续设立华宇半导体、深圳泰美达等公司，深圳泰美达为发行人前控股股东，发行人历史上存在对外收购华宇创芯、华宇福宝股权，以及收购池州华钛、华宇芯业、华宇半导体、深圳泰美达资产情形；2025年5月21日，发行人股东赣州悦时景晟将持有的66.28万股份转让给合肥悦时景朗。请发行人：①结合收购前各个收购标的的业务开展情况，说明各个标的业务、资产、技术与发行人的关系，收购取得的技术是否存在纠纷或潜在纠纷。②结合被收购时点各个标的的股权结构，说明收购时点除发行人实际控制人外的其他主体的入股背景、与发行人的关系，发行人收购价格是否公允，是否存在损害发行人利益的情形。③说明合肥悦时景朗入股背景、入股价格测算方式及公允性，是否存在利益输送或其他利益安排。

（3）内部控制制度有效性。根据申请文件及公开信息，报告期内发行人及子公司共存在6次因违法违规被主管机关处罚，其中5次涉及罚款，同时发行人存在销售发货、

审批流程瑕疵、个人卡收款、第三方回款、公司章程内容不完备等问题。请发行人：①说明公司治理制度建设及机制运行情况，包括但不限于公司治理、投资者保护、信息披露制度建设情况，并说明报告期内公司治理不规范情形的整改有效性。②逐项说明发行人报告期内违法违规情形发生的原因，发行人采取的针对性整改措施及效果，是否构成重大违法违规及相应判断依据。结合报告期内发行人海关出口、环保等方面违法违规情形，说明发行人内部控制制度是否得到有效执行，报告期后是否存在新增违法违规情形。③说明第三方回款资金流、实物流与合同约定及商业实质是否一致，说明相关收入是否真实、是否存在虚构交易或调节账龄的情形；说明报告期内财务内控不规范情形的整改情况，票据、资金管理等相关内控制度是否健全并有效执行。

请保荐机构核查上述事项并发表明确意见。请发行人律师核查问题（1）-（3）之①②并发表明确意见。请申报会计师核查问题（3）之③并发表明确意见。请保荐机构、申报会计师说明按照《2号指引》2-10 财务内控不规范情形相关要求进行检查的情况。请保荐机构、发行人律师按照《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务规则适用指引第1号》1-2 申报前引入新股东与增资扩股情形相关要求进行检查的情况。

除上述问题外，请发行人、保荐机构、申报会计师、发行人律师对照《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 46 号——北京证券交易所公司招股说明书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 47 号——向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请文件》《北京证券交易所股票上市规则》等规定，如存在涉及股票公开发行并在北交所上市条件、信息披露要求以及影响投资者判断决策的其他重要事项，请予以补充说明。